

特种工程材料
电气与电子解决方案

用于5G基站天线应用的 EDGETEK™ Dk/Df高频介质材料



随着材料前置周期的不断缩短,5G天线可更快速地满足设计要求,加快5G基础设施的部署进程。基站密度覆盖率的增加也亟需进一步优化的5G天线。埃万特可在一周内定制特定介电常数(Dk)的5G天线材料配方和样品,并在两至三周内完成批量交付。与传统材料相比,除了加快上市速度,我们的定制配方还可以提高您设计的灵活性,提供更高的性价比。

EDGETEK™ Dk/Df高频介质材料*

	ET7600-8027	ET7600-8025	ET7600-8037	ET7600-8019	ET7600-8028	ET7600-8026	ET7600-8044	ET7600-8029	ET7600-8041	ET7600-8045	ET7600-8048	ET7600-8036	ET7600-8056	ET7600-8031
基础树脂	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE	PPE
介电常数 (Dk)	3.0	3.1	3.35	3.6	3.8	4.4	4.8	5.28	5.4	5.85	6.0	7.0	7.3	9.0

*埃万特可定制介电常数为3.0和9.0之间的该系列配方,满足特定的天线设计要求。



埃万特定制聚合物配方如何为5G基站天线相移带来优势

加快产品设计规范、缩短前置时间 - 埃万特可在一周内按照要求的Dk值定制材料配方和样品，并在两至三周内批量交付。

特定Dk值材料 - 我们的定制配方可在3.0 Dk和9.0 Dk之间为您的天线设计提供所需的Dk值。

低损耗因数(Df)材料 - 我们的解决方案所使用的基础配方的Df值小于0.002。

良好的尺寸稳定性 - 我们的解决方案的尺寸公差在 $\pm 0.2\text{mm}$ 之内。

一致的Dk质量 - 可测试Dk值，验证一致性。

缩短上市周期，提高设计灵活性 - 热塑性配方的制样和验证快于陶瓷或打印电路板(PCB)等传统材料。此外，利用可注塑材料，还可以实现独特的天线设计和复杂的形状，而传统材料可能只能制作形状简单的样品。

更高的性价比 - 与热塑性塑料解决方案相比，传统材料的成本高出30-40%，而性能仅略占优势。

小组件制造能力 - 热塑性塑料可模制体积更小的组件，而使用传统材料的制造工艺则无此功能。

如欲了解更多，请访问www.avient.com

或致电+86 021 60284888



www.avient.com



版权所有©2020埃万特公司。对于本文中所含信息就其在特定应用的准确性、适用性、以及通过使用这些信息而获取或可能获取的结果，埃万特不做任何表示、保证和担保。某些信息来自使用小型设备的实验室测试，可能无法可靠指明使用大型设备时获得的表现和性能。“典型”数值或未给出范围的数值不能代表最低或最高性能；关于性能范围和规格范围信息，请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料性质背离该文件给出的数值。埃万特对于埃万特的产品或者用于贵司工艺或者终端应用的信息的实用性不做任何担保或保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试，以确定产品是否适用于您的应用工艺，同时您还需承担因使用这些资料或/或处理任何产品导致的任何风险和责任。对于这些资料或资料中所提及的产品，埃万特不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对特定用途的适用性和合适性的暗示保证。未经专利所有者许可，本数据表不得作为使用任何专利发明的许可、建议和诱因。